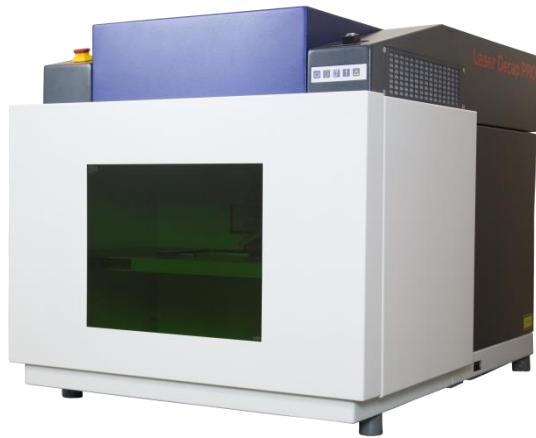


レーザーパッケージ開封



当社導入のレーザーパッケージ開封装置は、ボンディングワイヤ (Au, Cu)、チップへのダメージが低いレーザーを搭載しています。難しいCuワイヤパッケージ開封の事前加工が容易となり、精度の高い開封、観察が可能です。

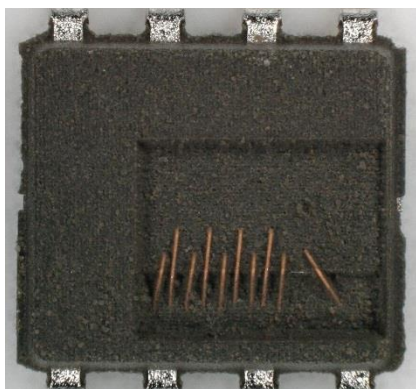


【ハイソル社 Laser Decap PRO】

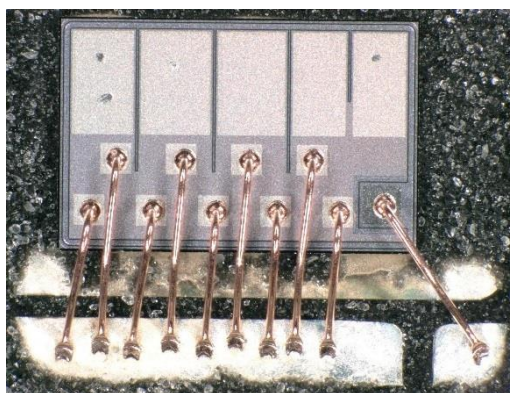
レーザー Nd・YVO4レーザー
波長 1,064nm
定格出力 >9W
周波数 0-200kHz
加工範囲 120mm×120mm

【8pin SOP Cuワイヤパッケージの開封】

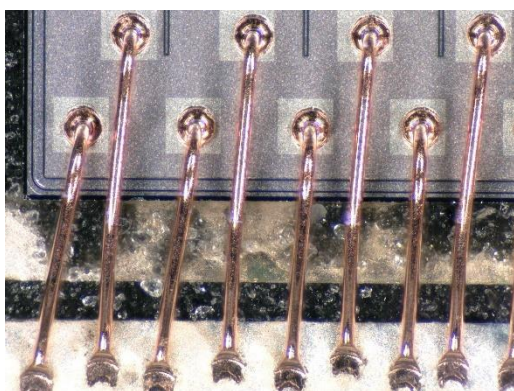
レーザー開封



薬液開封後内部状態



1st側ボンディング状態



2nd側ボンディング状態



内藤電誠工業株式会社 評価解析事業部

213-0011 川崎市高津区久本3-9-25

TEL: 044-811-5496 FAX: 044-850-5851

<https://www.lab.ndk-grp.co.jp/>